

# 3D パッケージソリューション

## 3D PACKAGING

### 銅核ボール

### 受動部品実装

- 溶剤洗浄 Type5 ソルダペースト **M10-PHW**
- 補充用ソルダプリフォーム **Chip Solder 0402**
- ハロゲンフリー極細線や入りはんだ **CBF**

### パッケージング

- 耐熱疲労と耐落下衝撃性を両立 **ソルダボール M770**
- 高耐熱疲労ソルダボール **M60**
- 形状保持力の高い **銅核ボール**
- POP 用ソルダペースト **NSV300** シリーズ
- 接合補強用ソルダペースト **JPP**
- 低揮発水溶性フラックス **WF-6317**

### 部品内蔵実装

- 接合とスペース確保を両立する **銅核ボール**
- 再熔融を防止するソルダペースト **RAM** シリーズ

### 半導体実装

- NWO 対策無洗浄ソルダペースト **S101-S4-HF**
- 無洗浄 Type5 ソルダペースト **M705-RGS800HF**

### バンプ形成

- $\phi 100\mu\text{m}$  以下 ソルダボール / LASボール **M705 / M200**
- $\phi 100\mu\text{m}$  以下 **銅核ボール / 銅ボール**
- 転写用ソルダパウダー **PPS**
- 微小バンプ形成用ソルダペースト **M200-BPS**
- ボール形成用フラックス **MB-T100**

### ボールアタッチ(ボール接続)

- POP 用ソルダペースト / フラックス **NSV320 / NSV300**
- 超低残渣フラックス **901K5**
- 水溶性フラックス **SPK-300** シリーズ
- 無残渣フラックス **JPK8**
- 銅ピラー用接合材料 **PPS**

### 製造装置

- 半導体実装用  $\text{N}_2$  リフロー炉 **SNR-1346MB**